

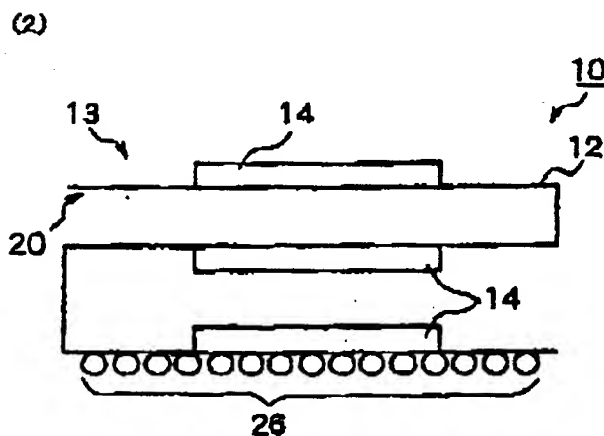
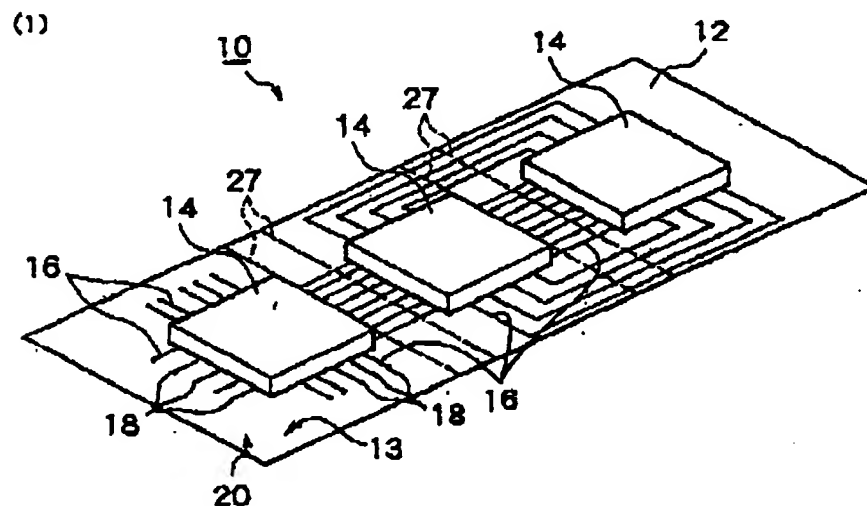
提出日 平成12年 1月12日

整理番号=J0074549

頁: 1/ 5

【 類名】 図面

【図1】



10: SEMICONDUCTOR DEVICE
12: CONNECTION SUBSTRATE
14: SEMICONDUCTOR CHIP
16: 1st METALLIC WIRING

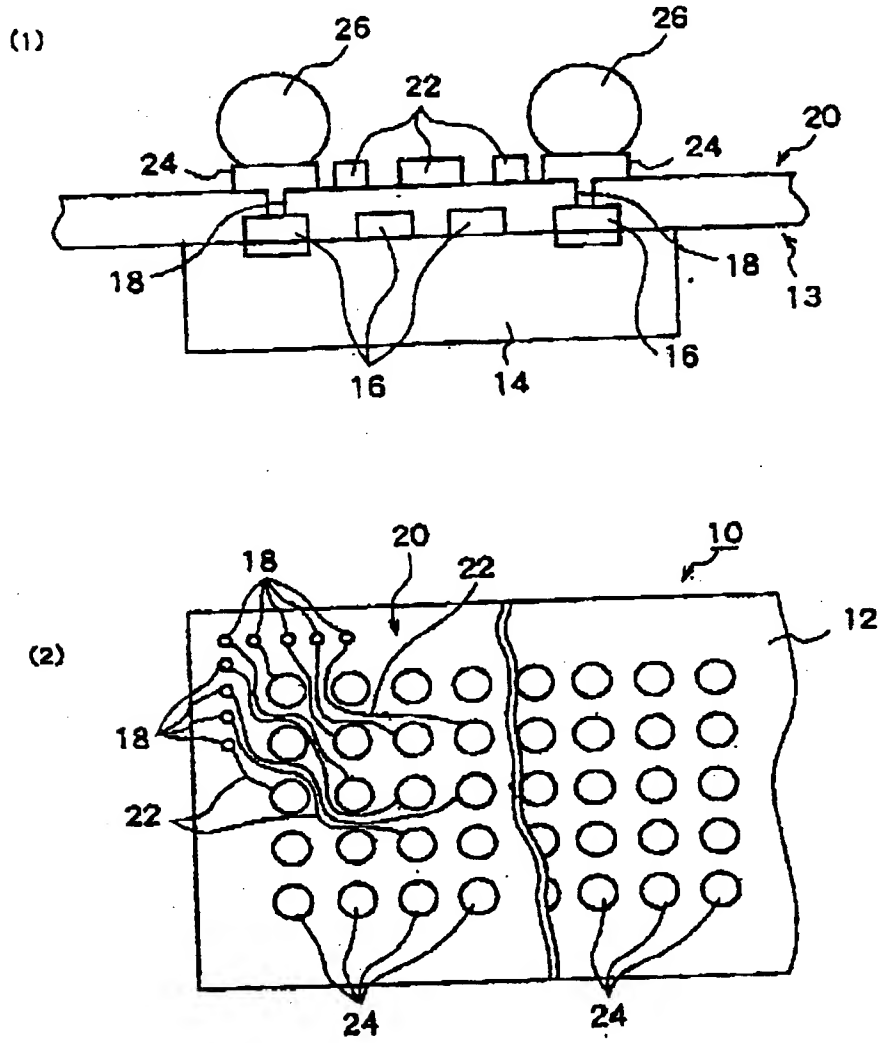
100110-48812500

提出日 平成12年 1月12日

頁: 2/ 5

整理番号=J0074549

【図2】



0051004-01001

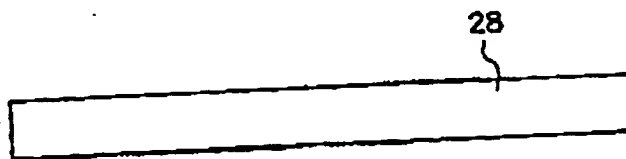
提出日 平成12年 1月12日
頁: 3/5

頁: 3/

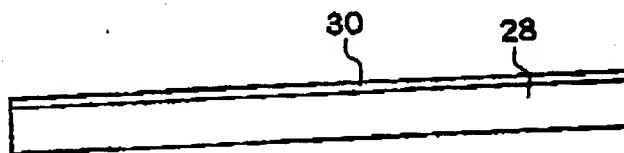
整理番号=J0074549

【圖3】

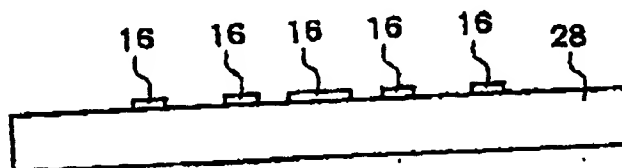
(1)



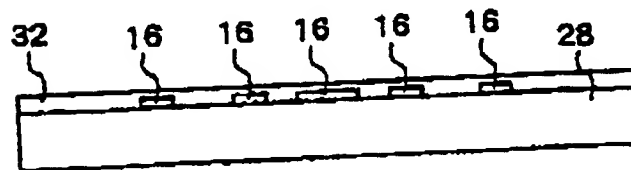
(2)



(3)



(4)

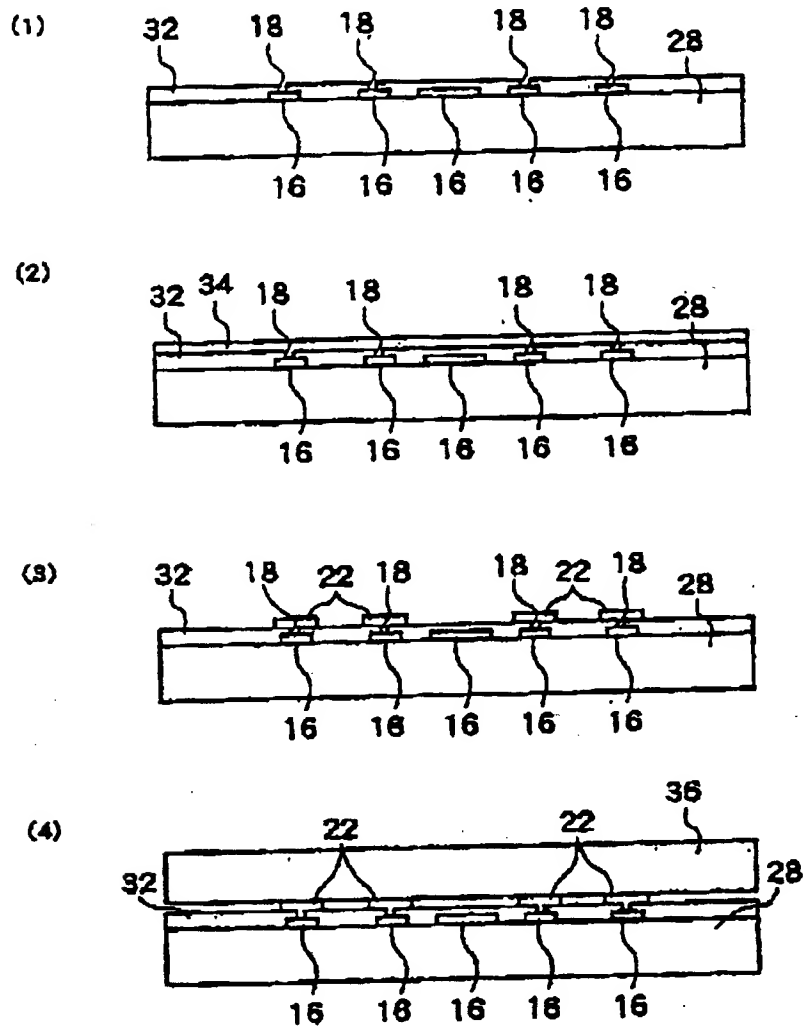


提出日 平成12年 1月12日

整理番号=J0074549

頁: 4/ 5

【図4】



整理番号=J0074549

【図5】

